

補充液不要、Sn-Biめっきのコストダウンを実現

No replenisher required; reduces Sn-Bi plating costs

特長

● 均一で微細な結晶粒径は、空孔濃度を減少させ電気抵抗を減少させる。

□ 製造工程での省エネと
高品質なめっき皮膜を形成する

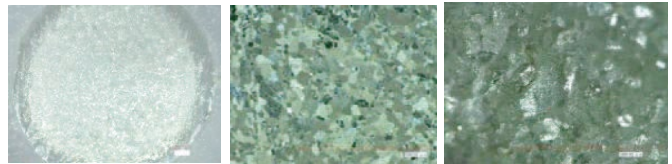
□ 結晶粒径が微細で揃っている



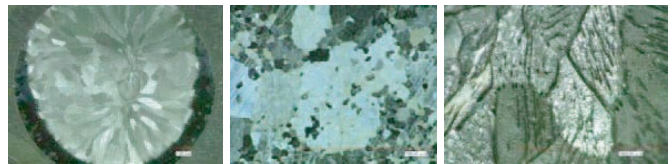
SMIC製

他社製

SMIC製



他社製

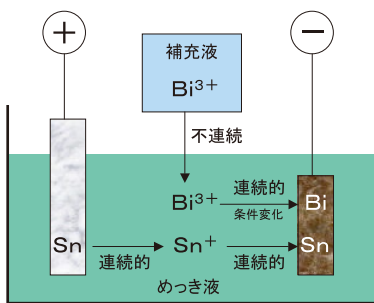


製品仕様

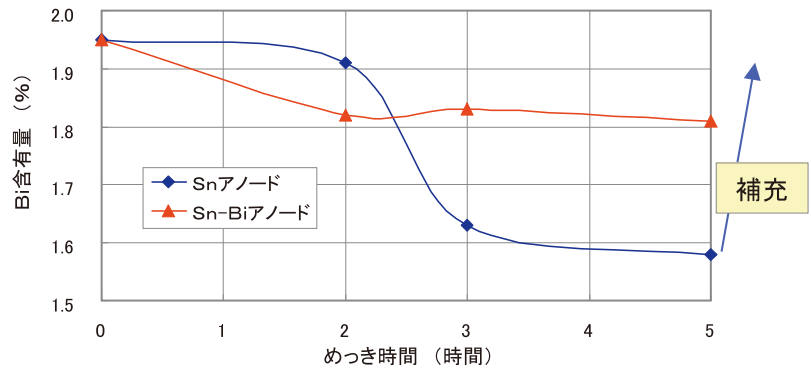
□ 補充液なしで、Sn-Biめっきの
コストダウンを実現

□ Snアノードによるめっきは、定期的に補充液でBi含有量を調整

SnアノードでのSn-Biめっき

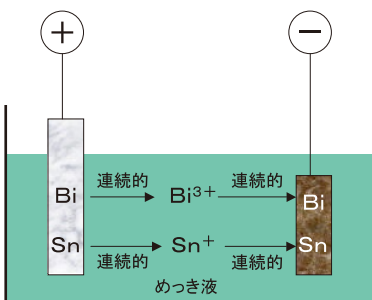


Bi³⁺濃度は変化、定期的に補充



□ Sn-Biアノードは、均質なめっき皮膜を実現 (ウイスカのリスク低減)

Sn-BiアノードでのSn-Biめっき



Bi³⁺濃度は一定

